

Halbleiter-Testzentrum für Chips und Sensoren in Penang, Malaysia

August 2023

Allgemeine Informationen

Mit dem neuen Halbleiter-Testzentrum in Penang schafft Bosch zusätzliche Kapazitäten innerhalb seines weltweiten Fertigungsverbundes, um der weiterhin hohen Nachfrage nach Chips und Sensoren gerecht zu werden. Es rückt Bosch näher an die Anbieter von Halbleitermontage, -verpackung und -prüfung (so genannte OSATs) in der Region sowie an die Kunden des wichtigen asiatischen Marktes heran.

Investitionssumme:	2023: 65 Millionen Euro; Bis Mitte der nächsten Dekade ist ein Investment von weiteren 285 Millionen Euro am Standort geplant.
Grundstück:	100.000 m ² davon 18.000 m ² für Reinräume, Büroflächen sowie Labore für Qualitätssicherung und Fertigung.
Reinraumfläche Endprüfung:	3.000 m ² ; zusätzliche 3.000 m ² befinden sich gerade im Bau und sollen bis Ende 2023 fertiggestellt sein.
Bauverlauf:	Spatenstich: 05/2021 Erster Produktionsdurchlauf: 01/2023 (ASIC) Eröffnung: 08/2023

Hochfahren der Produktion:
08/2023

Mitarbeitende:

Bis Mitte der nächsten Dekade werden bis zu 400 Mitarbeitende im Halbleiter-Testzentrum beschäftigt sein.

Arbeitsschritte im Backend:

Einzelne Chips werden aus den Wafern getrennt, montiert und getestet.

Gefertigte Produkte:

Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), MEMS Sensoren

Einsatzgebiete:

Elektronische Steuerungen für Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsysteme wie Airbag, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) oder Einparkhilfe;
Elektronische Steuerungen für Elektro- und Verbrennungsmotoren